

# REINIGEN®S2011

## 清除焊锡膏和 SMT 胶水的水基网板清洗剂

REINIGEN®S2011 是特别设计在室温条件下清洗 SMT 网板的水基清洗剂。REINIGEN®S2011 既可以在同一个工艺中有效清除焊锡膏和 SMT 胶水，也可以被用在印刷机内的网板底部擦拭应用中。REINIGEN®S2011 设计应用在喷淋和超声清洗系统，同时也被推荐用于清除错印焊锡膏。REINIGEN®S2011 同样可以用在双面和单面焊接线路板的清洗应用中，不过这要取决于待清除的助焊剂类型。

应用领域：网板和误印线路板清洗		更多信息：
焊锡膏（焊前）	++	技术信息 2：所有经测试的助焊剂和锡膏概览 技术信息 3：材料兼容性概览 技术信息 4：印刷机内网板底部清洗应用的信息 应用指南： 清洗试验详细工艺参数推荐
SMT 胶水或导电胶水	++	
无铅助焊剂	00	
免洗助焊剂	00	
水溶性助焊剂残留物	+	

++强烈推荐，效果最佳， +推荐，00 可能， -不推荐。

### 优点（与其他清洗剂相比较）：

- 高清洗负载能力和非常好的可过滤性，保证了清洗剂的较长使用寿命和较低的维护成本。
- REINIGEN®S2011 是水基且不含表面活性剂成分的清洗剂，在干燥后不会在被清洗件表面上和清洗设备内部留下残留物。
- 能在室温条件下使用。
- REINIGEN®S2011 是水基清洗剂，没有闪点，使用时无需防爆措施。
- 由于其温和配方，REINIGEN®S2011 对网板有极好的材料兼容性。
- 可以应用在喷淋系统、超声浸洗槽和印刷机中。
- 可以应用在闭环清洗系统中。
- 应用在喷淋系统中不会产生泡沫。
- 气味低，在漂洗单元不会有有机物沉积。

清洗塑料前请参考材料兼容性表（技术信息 3）。

REINIGEN®S2011 已经得到许多世界领先的清洗设备和网板制造商的认可。

工艺	清洗	漂洗	干燥
喷淋	REINIGEN®S2011	REINIGEN®S2011、水或去离子水	热风或循环空气
超声	REINIGEN®S2011	REINIGEN®S2011、水或去离子水	热风或循环空气
印刷机内	REINIGEN®S2011	不适用	真空干燥

• 使用普通的水漂洗网板可能是可行的，不过这要取决于水的硬度。硬度较大时，干燥后可能会在网板上留下痕迹。而对于误印版的清洗应用，则要求使用去离子水来漂洗。

<b>技术参数</b> REINIGEN® S2011 可以提供浓缩液或即用液。 请注意本表采集数据自 REINIGEN® S2011 即用液。		
密度	g/ccm, 20°C/68°F	0.99
表面张力	mN/m, 25°C/77°C	29.7
沸程	°C/°F	95-212/203-414
闪点	°C/°F	无
PH 值	10g/1H <sub>2</sub> O	中性
蒸汽压	Mbar, 20°C/68°F	18.1
水溶性		可溶
清洗温度	°C/°F	20-30/68-86
应用浓度	即用液	100%
应用浓度 <sup>1</sup>	浓缩液	25%
HMIS 级别	健康性-燃烧性-反应活性	0-0-0

<sup>1</sup> 使用 REINIGEN® S2011 浓缩液时必须使用去离子水稀释。

#### 符合无铅标准:



REINIGEN® S2011 符合新版 ROHS 和 WEEE 指令，以及劳工安全和环境标准。REINIGEN 公司在产品研发阶段主动避免此类物质的使用。



详细的测试确认 REINIGEN® S2011 有能力清洗无铅锡膏。有关详细信息，请参考其技术信息 2。

#### 环保、健康及安全法规:

REINIGEN® S2011 配方中不含任何卤素化合物，并可完全生物降解。使用 REINIGEN® S2011 时一定要用水来进行漂洗，这会使得清洗时不需要去离子水和水处理工艺。操作处理过程无需特别防护。

#### 包装/贮存:

REINIGEN® S2011 提供机用液和浓缩液包装，包括 10 升壶装及 20 升桶装、25 升桶装。本品为非危险品，根据欧盟法规无需特别标识。

REINIGEN® S2011 可贮存于 5-30°C/41-86°F 温度环境下的原始包装中。在工厂密封条件包装下可以保持至少 3 年的有效期。